



中华人民共和国国家标准

GB/T 15873—1995

半导体设施接口技术文件编写导则

Directives for drafting semiconductor
facilities interface specification

1995-12-22 发布

1996-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

半导体设施接口技术文件编写导则

GB/T 15873—1995

Directives for drafting semiconductor
facilities interface specification

1 主题内容与适用范围

本标准规定了半导体设施接口技术文件(以下简称接口文件)编写的基本要求和格式。
本标准适用于半导体设施的设计、施工、供应、管理、培训及使用。

2 引用标准

GB/T 13840 晶片承载器

3 接口文件的基本要求

3.1 接口文件的一般构成和编写顺序

概述部分——	封面与首页
	目录
	接口文件名称
	引言
正文部分——	供需管理接口文件要求
	安全文件要求
	设施文件要求
	装运文件要求
	安装文件要求
	厂房和动力设施验收测试文件要求
	设备起动验收测试文件要求
补充部分——	培训要求
	附件
	其它

正文部分的每一条目必须列出。即使没有具体要求,也应在该条目中加以说明。

3.2 供需管理接口文件要求

供需管理接口文件一般应包括购销联络文件、生产安装文件、设备概况。

3.2.1 购销联络文件

购销联络文件应写明供需双方代理单位的名称、联络地址、联系人、职务、电话、传真号等,并注明日期。购销联络文件格式见附录 A(补充件)中的表 A1。

3.2.2 生产安装文件

生产安装文件应写明供方生产单位和需方安装使用单位的名称、地址、联系人、职务、电话等。生产安装文件格式见附录 A(补充件)中的表 A2。